

ISSN 1681-1070
CN 32-1709/TN

电子与封装

ELECTRONICS & PACKAGING

中国电子学会电子制造与封装技术分会会刊

中国半导体行业协会封装分会会刊



QK2008803



陶瓷封装恒定加速度试验的
分析与改进

P030201

激光焊接的热冲击对
玻璃绝缘子的影响

P030202

ISSN 1681-1070



9 771681 107203

www.ep.org.cn

主管：中国电子科技集团公司

主办：中国电子科技集团公司第五十八研究所

2020年3月
第20卷第3期



扫码关注杂志
微信公众号

万方数据

中国电子学会电子制造与封装技术分会会刊

中国半导体行业协会封装分会会刊

电子与封装

Dianzi Yu Fengzhuang

2001年创刊(月刊)

2020年3月第20卷第3期

(总第203期)

编辑委员会

顾问: 王阳元 叶甜春 许居衍
俞忠钰 郑敏政 郝跃
宫承和

名誉主任: 毕克允

主任: 李斌

副主任: (按姓氏笔画排序)

王红 王新潮 石明达
肖胜利

委员: (按姓氏笔画排序)

丁荣峥 于宗光 田艳红
王栋 王静 刘胜
庄奕琪 李丽 肖志强
时龙兴 陆坚 沈阳
张卫 张波 张崎
金玉丰 罗宏伟 卓鸿俊
明雪飞 封晴 高岭
徐冬梅 顾晓峰 黄凯
程凯 曹立强 蔡坚

主管: 中国电子科技集团公司

主办: 中国电子科技集团公司
第五十八研究所

编辑出版: 《电子与封装》编辑部

主编: 余炳晨

万方数据

目次

封装、组装与测试

- 030201 陶瓷封装恒定加速度试验的分析与改进
.....丁荣峥, 蒋玉齐, 吕栋, 仝良玉
- 030202 激光焊接的热冲击对玻璃绝缘子的影响.....陈杰, 王韩

电路设计

- 030301 基于复合基板微波电路设计的小型化TR组件
.....张帅, 杨志保, 吴天阳, 张晖
- 030302 基于FPGA的线列阵波束形成器设计.....晏慧强, 王妍婷
- 030303 一种基于BLDC电机的矢量控制电路设计.....耿永, 王贤会
- 030304 自适应带宽锁相环建模分析与验证
.....沈广振, 杨煜, 赵玉月
- 030305 本征模在电源完整性分析中的应用
.....张诚, 周倩蓉, 曾燕萍, 毛臻
- 030306 基于PowerPC架构的二级启动设计
.....杨露, 张荣, 张梅娟, 葛秀梅, 何佩佩
- 030307 一款采用超前相位补偿技术的低压差线性稳压器
.....曹正州, 张艳飞, 孙佩

微电子制造与可靠性

- 030401 氟掺杂对非晶硅薄膜特性的影响
.....郑若成, 王印权, 刘佰清, 郑良晨
- 030402 P型外延电阻率表面态的研究
.....仲张峰、韩旭、潘文宾、葛华、尤晓杰、王银海、杨帆

产品、应用与市场

- 030501 基于RFID的半导体企业仓储偶极子天线
.....赵超男, 王猛, 倪晓东

期刊基本参数: CN32-1709/TN * 2001 * m * 16 * 56 * zh+en * p * ¥10.00 * 1200 * 12 * 2020-03

Electronics & Packaging

(Monthly)
Vol. 20, No. 3
Mar. 2020

CONTENTS

Packaging & Assembly & Testing

- 030201** Simulation Analysis and Verification of Constant Acceleration Test for Ceramic Package
.....DING Rongzheng, JIANG Yuqi, LYU Dong, TONG Liangyu
- 030202** Effect of Thermal Shock of Laser Welding on Glass Insulator.....CHEN Jie, WANG Han

IC Design

- 030301** Miniaturized TR Module Based on Microwave Circuit Design of Composite Substrate
.....ZHANG Shuai, YANG Zhibao, WU Tianyang, ZHANG Hui
- 030302** Design of Linear Array Beamformer Based on FPGA
.....YAN Huiqiang, WANG Yanting
- 030303** Design of Controller System Based on BLDC Motor
.....GENG Yong, WANG Xianhui
- 030304** Adaptive Bandwidth Phase-locked Loop Modeling Analysis and Verification.....SHEN Guangzhen, YANG Yu, ZHAO Yuyue
- 030305** Application of Eigen Mode on Power Integrity Analysis
.....ZHANG Cheng, ZHOU Qianrong, ZENG Yanping, MAO Zhen
- 030306** Secondary Startup Design Based on PowerPC Architecture
.....YANG Lu, ZHANG Rong, ZHANG Meijuan, GE Xiumei, HE Peipei
- 030307** Low-Dropout Regulator with Phase-Lead Compensation
.....CAO Zhengzhou, ZHANG Yanfei, SUN Pei

Microelectronics Fabrication & Reliability

- 030401** Influence of Fluorine Doping on the Characteristic of Amorphous Silicon Thin Films
.....ZHENG Ruocheng, WANG Yinquan, LIU Baiqing, ZHENG Liangchen
- 030402** Study on the Surface State of P-type Epitaxial Resistivity
.....ZHONG Zhangfeng, HAN Xu, PAN Wenbin, GE Hua, YOU Xiaojie, WANG Yin Hai, YANG Fan

Products & Applications & Markets

- 030501** Research on RFID-based Semiconductor Enterprise Storage Dipole Antenna
.....ZHAO Chaonan, WANG Meng, NI Xiaodong
万方数据

《电子与封装》编辑部

地 址：无锡市建筑西路777号

邮 编：214072

电 话：0510-85860386

传 真：0510-85802157

电子邮箱：ep.cetc58@163.com（稿件咨询）

ep1_cetc58@163.com（公众号合作）

ep2_cetc58@163.com（编务、发行）

投稿官网：www.ep.org.cn

公 众 号：电子与封装(ep_cetc58)

刊 号：ISSN 1681-1070
CN 32-1709/TN

印 刷：无锡市人民印刷厂有限公司

发 行：《电子与封装》编辑部

发行范围：国内外公开发行

广告经营许可证：3202010530010

出版日期：每月20日

定 价：10元

《电子与封装》编辑部声明

为适应我国信息化建设，扩大本刊及作者知识信息交流渠道，本刊已被以下数据库等收录，其作者文章著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意文章被收录，请在来稿时向本刊声明，本刊将作适当处理。

CNKI中国期刊全文数据库收录期刊

中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊

《中国核心期刊（遴选）数据库》收录期刊

“万方数据~数字化期刊群”上网期刊

《中文科技期刊数据库（全文版）》收录期刊

国家科技学术期刊开放平台

超星移动“域出版”平台

电子与封装

Dianzi Yu Fengzhuang

2001年创刊 (月刊)
2020年 3月 第20卷第 3期
(总第203期)

Electronics & Packaging

Started in 2001 (Monthly)
Vol. 20 , No. 3
Mar. 2020
(Series No. 203)

主 管: 中国电子科技集团公司
主 办: 中国电子科技集团公司
第五十八研究所
编辑出版: 《电子与封装》编辑部
编委主任: 李 斌
主 编: 余炳晨
地 址: 无锡市建筑西路777号
邮 编: 214072
电 话: 0510-85860386
传 真: 0510-85802157
电子邮箱: ep.cetc58@163.com
网 址: www.ep.org.cn
公 众 号: ep_cetc58
印 刷: 无锡市人民印刷厂有限公司
发 行: 《电子与封装》编辑部

Sponsored by: CETC58
Edited & Published by: Editorial Department of
Electronics & Packaging
Director of Editorial Board: LI Bin
Chief Editor: YU Bingchen
Add: No. 777 West Jianzhu Road,
Wuxi 214072, China
Tel: 86-510-85860386
Fax: 86-510-85802157
E-mail: ep.cetc58@163.com
Website: www.ep.org.cn
WeChat Official Account: ep_cetc58
Printed by: Wuxi People Printing Factory
Distributed by: Editorial Department of
Electronics & Packaging

刊号: ISSN 1681-1070
CN32-1709/TN
万方数据

发行范围: 国内外公开发行
定 价: 10.00 元